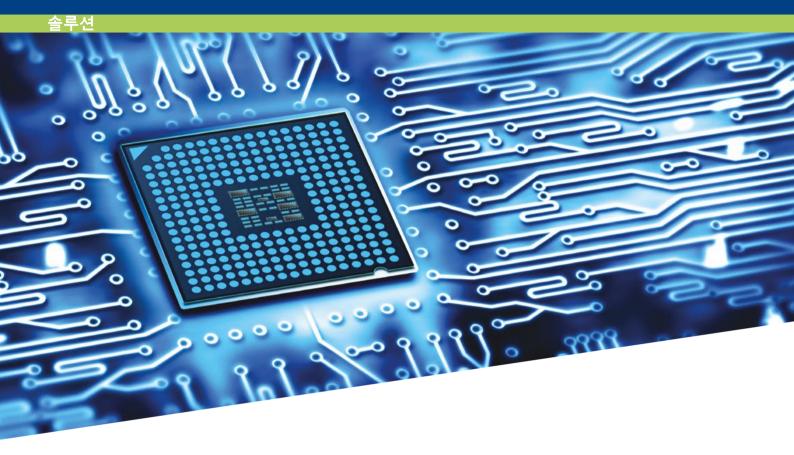
# 제조 수율을 최적화하는 신뢰할 수 있는 제품 반도체 산업을 위한 유체 제어 및 공압 솔루션



## 청정 환경에서의 칩 성능 및 신뢰성 보장

중요 반도체 응용 분야에 이상적인 에머슨 유체 제어와 공압 구성품 및 시스템은 클린룸에서 최소한의 매체 오염으로 높은 공정 순도와 정밀도를 보장합니다. 이에 따라 처리량을 높이고 제조 수율을 최적화합니다.

- 에머슨 유체 제어 및 공압 제품은 높은 수준의 성능 및 신뢰도를 제공하여 칩 제조 공정의 전체적인 신뢰성을 제고합니다.
- 제품은 특수 가스가 있더라도 최상의 성능을 선사하며, 유지 보수 필요성을 줄여주고 생산 중단 시간을 최소화합니다.
- IIoT 기능을 갖춘 이러한 제품은 온도, 유량, 압력, 위치제어를 통해 효율적인 에너지 사용이 가능하게 합니다.





### 제품 선택 사항









### AVENTICS™ 공압 제어 및 매니폴드 솔루션

- IIoT 응용 분야를 위해 설계됨
- 다양한 응용 분야(예: 소형 처리 시스템) 에 이상적임
- 밸브 및 통합 웹 서버에 대한 일관된 통신 전달

### ASCO™ 및 AVENTICS™ 비례 제어 밸브

- 공기 및 가스 유량 조정
- 컨트롤 체인 변경에 대한 신속한 반응성, 정밀한 유체 제어 제공
- 전 세계 수많은 기계와 공정 내에서 최적의 압력 제어 제공
- 차지하는 공간이 적으며 다양한 연결 옵션 제공

### ASCO™ 극저온 밸브

- 고성능 불소화 유체용으로 개발되었으며 광범위한 온도 지원
- 냉각기 및 온도 제어 기기에 사용하기 적합















### ASCO™ 일반 서비스 밸브

- 다양한 미디어 지원
- 2-way 솔레노이드 기술을 통해 견고하며 안정적임
- 응용 분야의 요건에 따라 신속하게 크기 조정 가능

### TESCOM™ 압력 제어 솔루션

- 여러 흐름에서 정확도, 정밀도, 안전성을 제공하며 압력 유지 및 제어
- 제조 공정 시 오염을 막고 웨이퍼 및 칩 불량을 방지하는 초고순도 설계 통합

### TESCOM™ 전환 및 전공 제어기

- 폐쇄 루프 PID 제어기 기반의 마이크로프로세서
- 모든 TESCOM 조절 장치 완전 자동화
- 25ms 반응 시간의 0.1% 정확도, 데이터 수집 및 원격 제어 기능 제공
- 전환 시스템으로 지속적인 공정 가스 공급 보장

### 에머슨 솔루션 제공





자세한 정보는 웹사이트를 참조하십시오. www.Emerson.com/Semiconductor